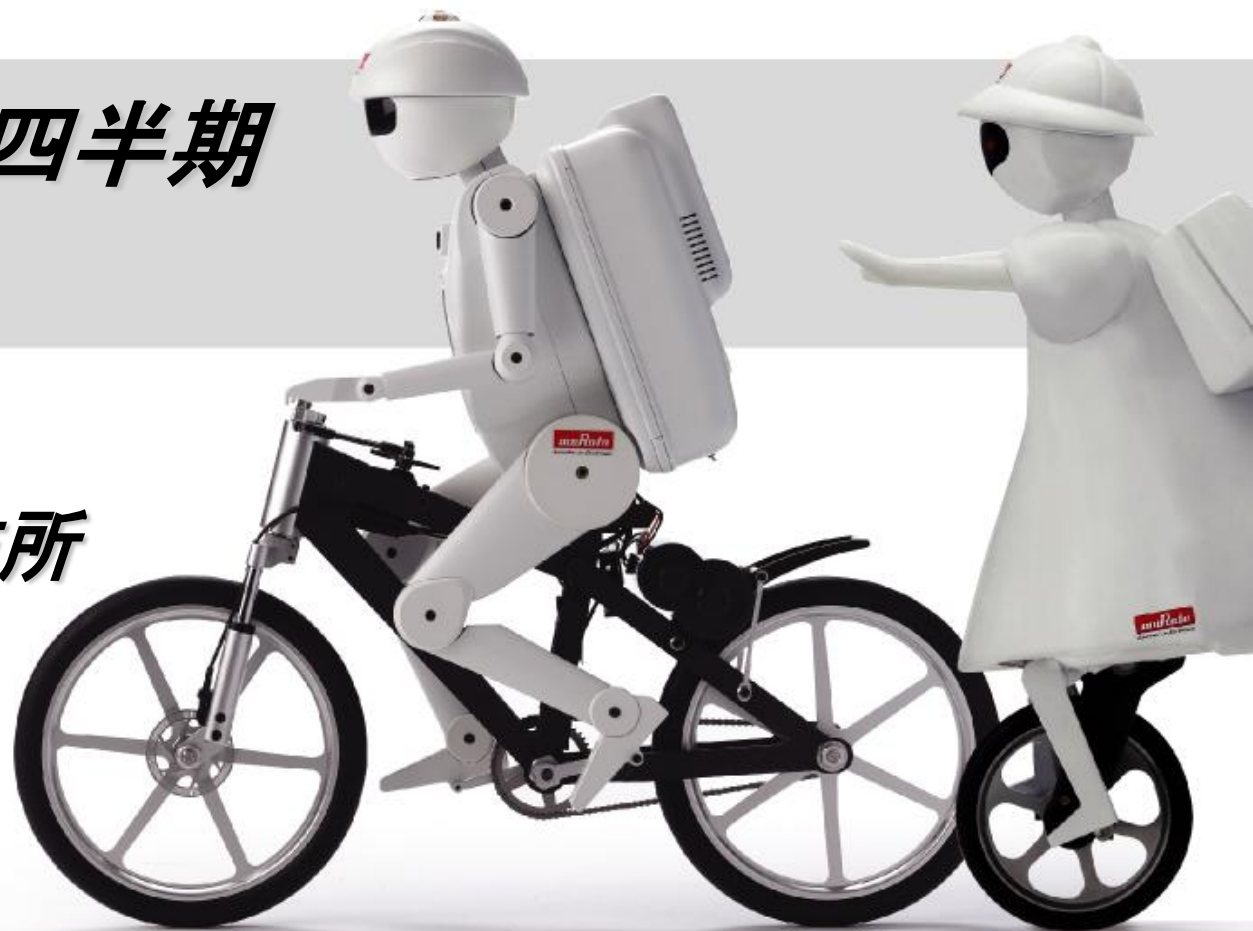


2011年度第3四半期 決算説明会

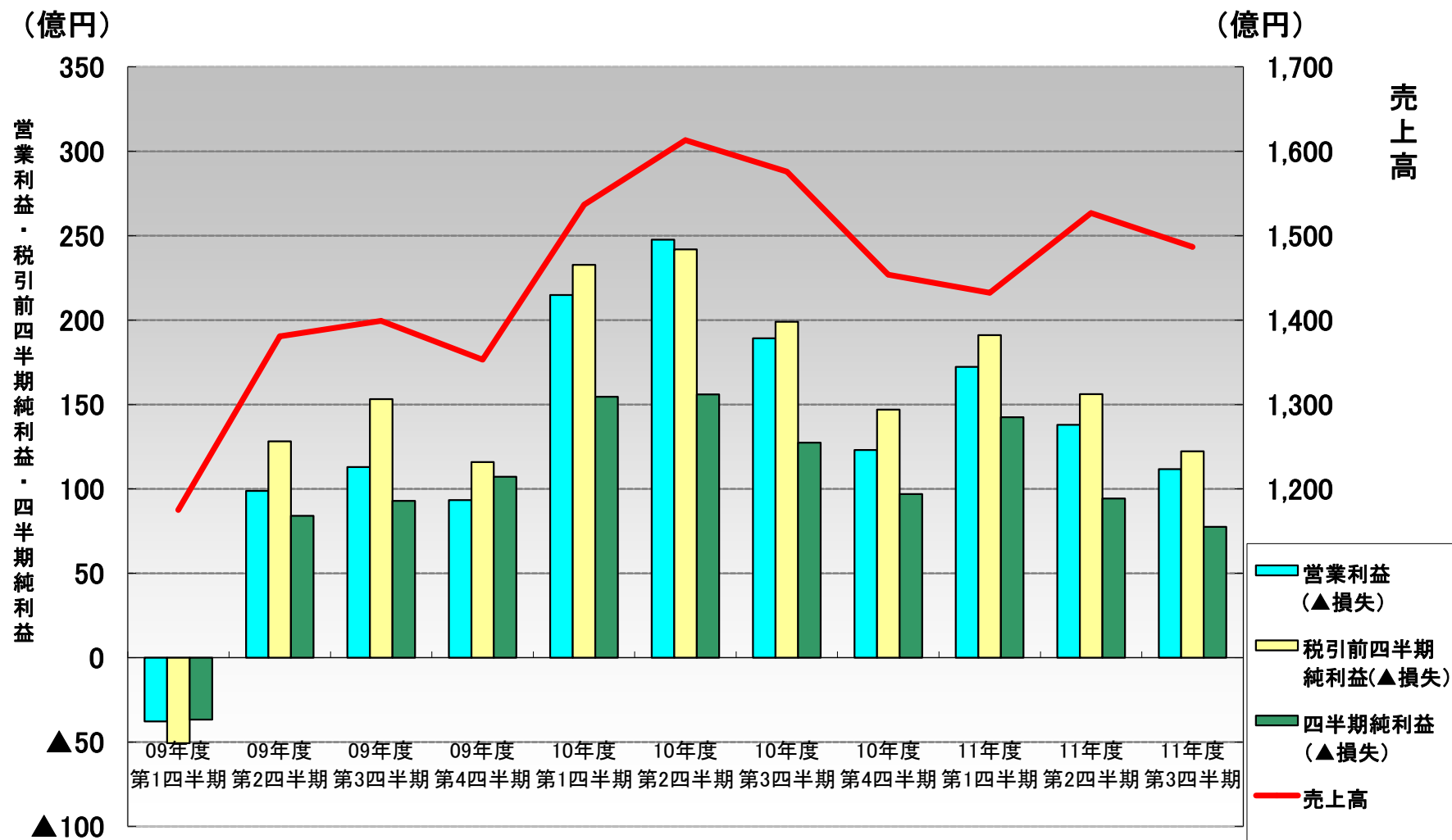
2012年1月31日
株式会社村田製作所



1. 2011年度 第3四半期業績概要

**2011年10月～2011年12月
第3四半期連結会計期間**

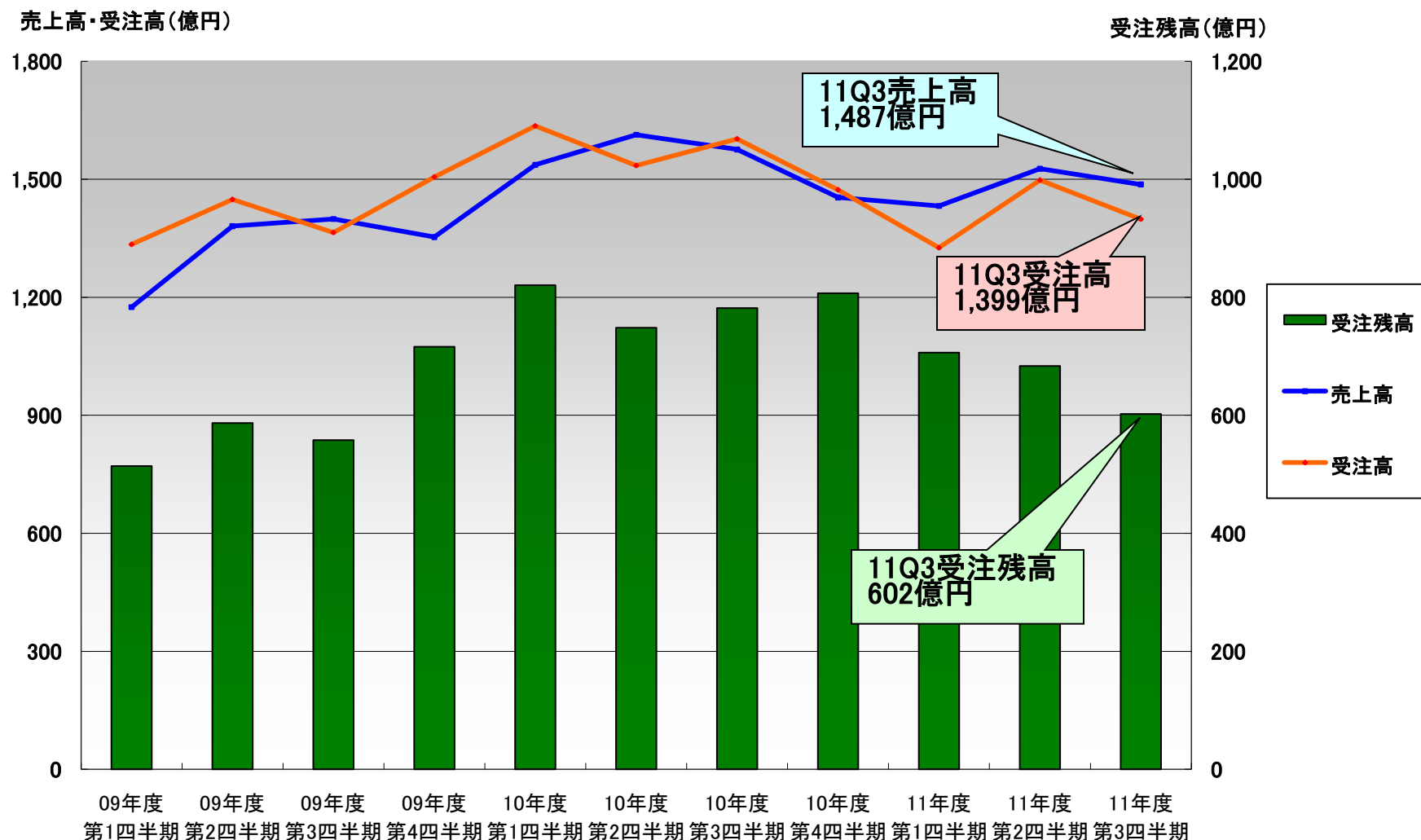
業績推移(四半期)



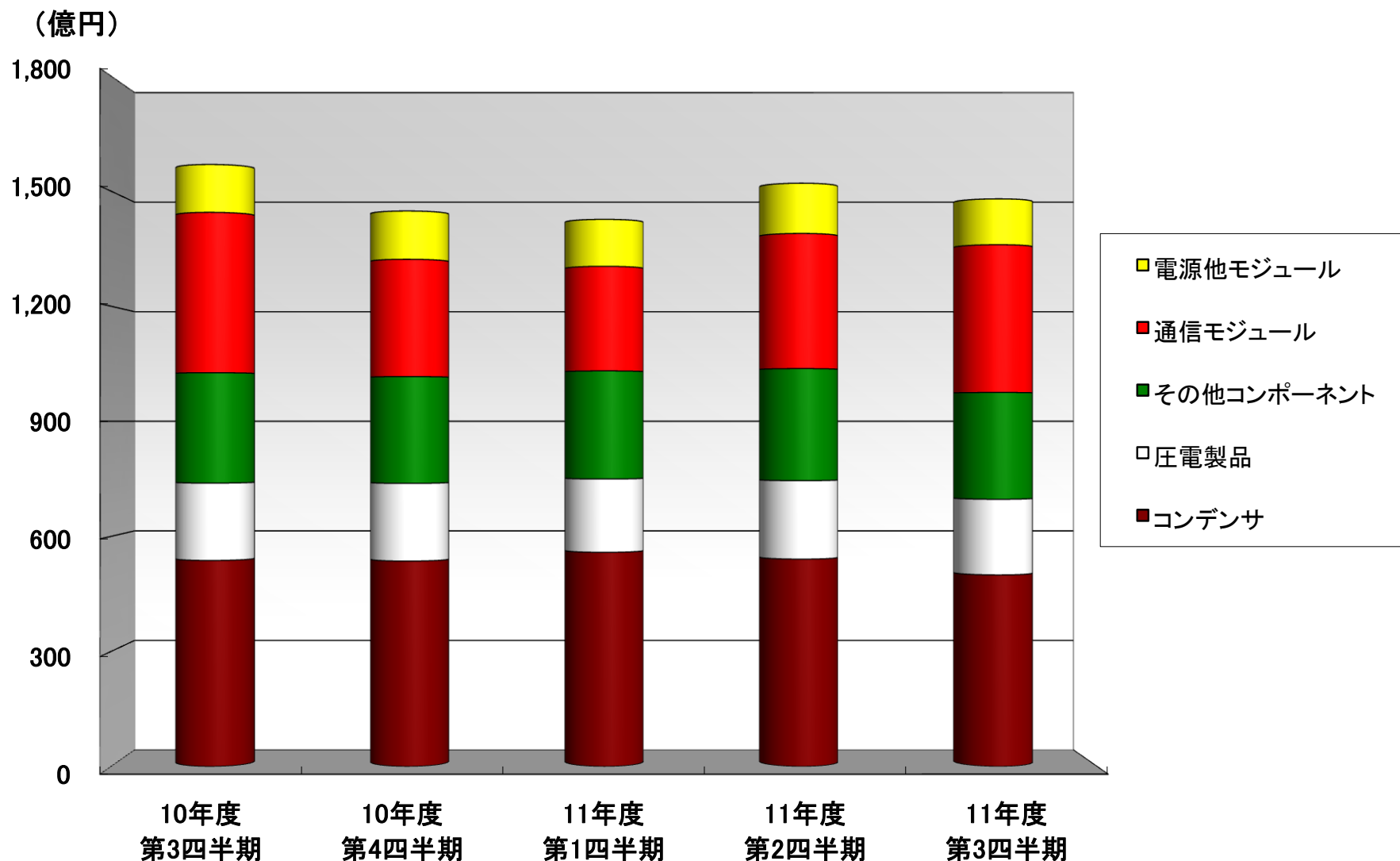
業績概況

	2010年度 第3四半期		2011年度 第2四半期		2011年度 第3四半期		前年同期比 11Q3/10Q3		直近四半期比 11Q3/11Q2	
	(億円)	(%)	(億円)	(%)	(億円)	(%)	(億円)	(%)	(億円)	(%)
売上高	1,576	100.0	1,527	100.0	1,487	100.0	▲89	▲5.7	▲40	▲2.6
営業利益	189	12.0	138	9.0	112	7.5	▲78	▲41.0	▲26	▲19.0
税引前 四半期純利益	199	12.6	156	10.2	122	8.2	▲77	▲38.6	▲34	▲21.7
四半期純利益	127	8.1	94	6.2	78	5.2	▲50	▲39.1	▲17	▲17.7

売上・受注・注残推移(四半期)



製品別売上高推移



製品別売上高

	2010年度 第3四半期		2011年度 第2四半期		2011年度 第3四半期		前年同期比 11Q3/10Q3		直近四半期比 11Q3/11Q2	
	(億円)	(%)	(億円)	(%)	(億円)	(%)	(億円)	(%)	(億円)	(%)
コンデンサ	537	34.2	541	35.5	500	33.8	▲38	▲7.0	▲41	▲7.6
圧電製品	202	12.9	205	13.5	197	13.3	▲4	▲2.2	▲7	▲3.6
その他 コンポーネント	288	18.3	292	19.2	279	18.8	▲9	▲3.2	▲14	▲4.6
通信モジュール	418	26.6	352	23.2	385	26.0	▲33	▲7.9	+33	+9.3
電源他 モジュール	125	8.0	131	8.6	120	8.1	▲5	▲4.2	▲11	▲8.7
製品売上高計	1,570	100.0	1,521	100.0	1,480	100.0	▲90	▲5.7	▲41	▲2.7

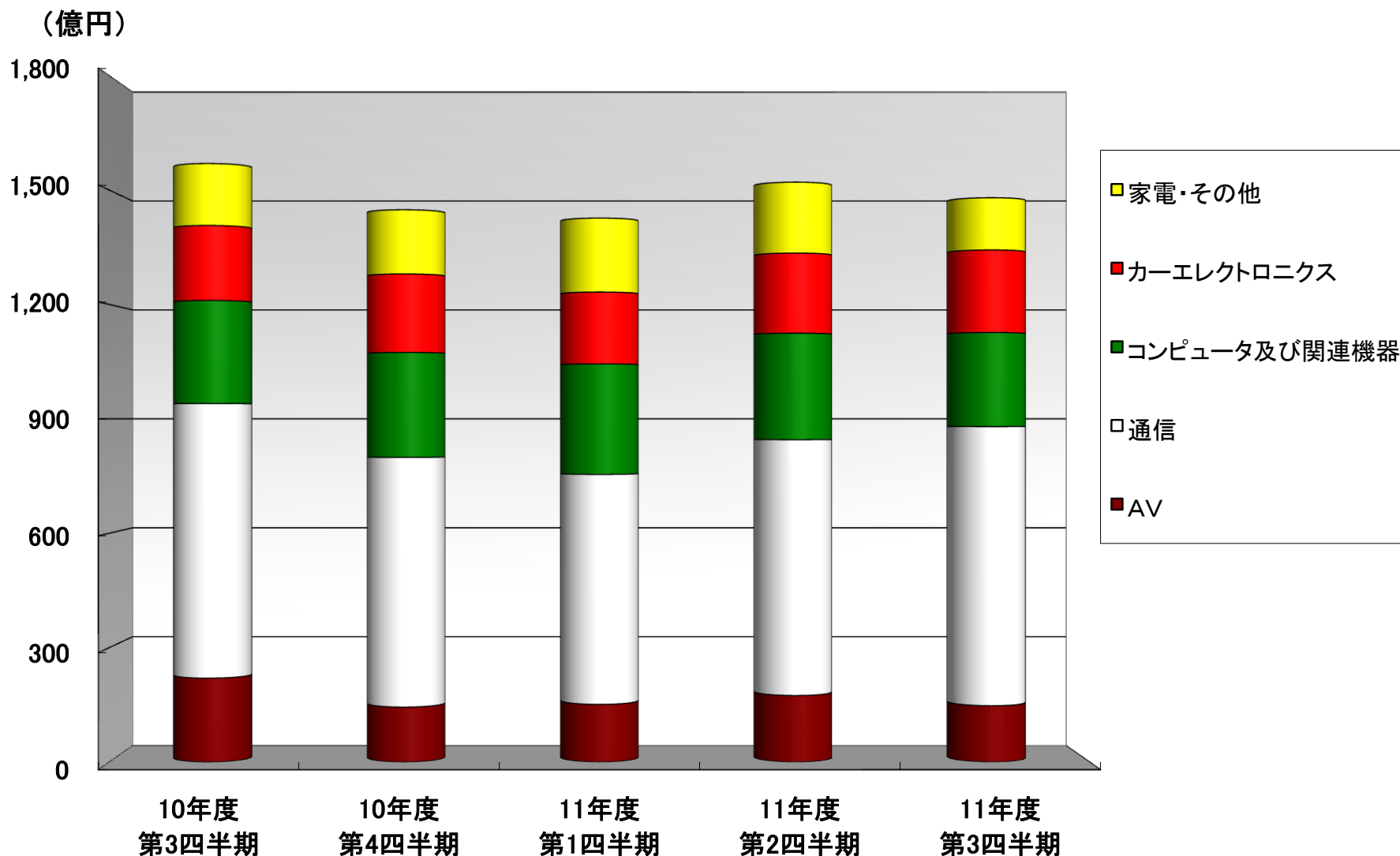
製品別売上高概況

(2011年度第2四半期→2011年度第3四半期)



コンデンサ (直前四半期比▲7.6%)	<チップ積層セラミックコンデンサ> 携帯電話、カーエレ向けが堅調も、 AV機器、コンピュータ及び関連機器向けが振るわず、全体では減少
圧電製品 (直前四半期比▲3.6%)	<表面波フィルタ> 携帯電話向けを中心に増加 <セラミック発振子> 家電、AV機器向けが減少 <圧電センサ> タイ洪水による得意先のHDD生産台数の減少で衝撃検知用センサ大幅減
その他コンポーネント (直前四半期比▲4.6%)	<EMI除去フィルタ> カーエレ向けが好調も、AV機器、通信機器向けが振るわず、全体では減少 <コイル> 携帯電話、カーエレ向けが増加 <コネクタ> 携帯電話向けが大幅増
通信モジュール (直前四半期比+9.3%)	<近距離無線通信モジュール> スマートフォン、車載向けが増加 <多層デバイス> 携帯電話向けを中心に大幅増
電源他モジュール (直前四半期比▲8.7%)	<電源> カーエレ向けが堅調も、その他用途が振るわず、全体では減少

用途別売上高推移



(注) 当社推計値に基づいております

用途別売上高

	2010年度 第3四半期		2011年度 第2四半期		2011年度 第3四半期		前年同期比 11Q3/10Q3		直近四半期比 11Q3/11Q2	
	(億円)	(%)	(億円)	(%)	(億円)	(%)	(億円)	(%)	(億円)	(%)
AV	220	14.0	174	11.5	148	10.0	▲72	▲32.9	▲27	▲15.3
通信	720	45.9	671	44.1	732	49.4	+12	+1.6	+61	+9.1
コンピュータ 及び関連機器	270	17.2	279	18.4	247	16.7	▲24	▲8.7	▲33	▲11.7
カーエレクトロニクス	197	12.5	210	13.8	216	14.6	+20	+10.1	+6	+3.1
家電・その他	163	10.4	186	12.2	137	9.3	▲25	▲15.6	▲49	▲26.3
製品売上高計	1,570	100.0	1,521	100.0	1,480	100.0	▲90	▲5.7	▲41	▲2.7

(注) 当社推計値に基づいております

用途別売上高概況

(2011年度第2四半期→2011年度第3四半期)

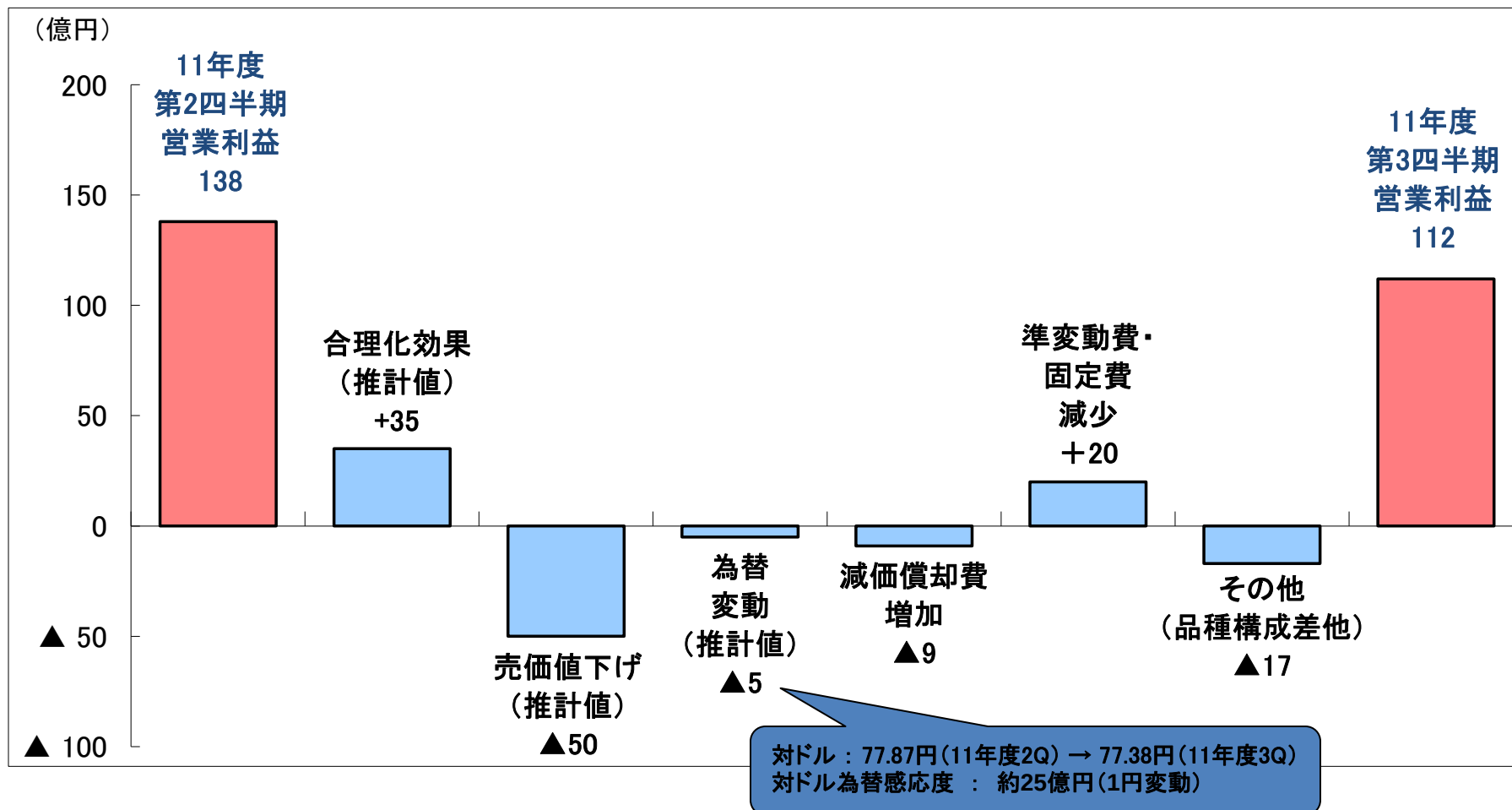


AV (直前四半期比▲15.3%)	チップ積層セラミックコンデンサ、電源、近距離無線通信モジュール減少
通信 (直前四半期比+9.1%)	多層デバイス、近距離無線通信モジュール、コネクタ、 表面波フィルタ増加
コンピュータ及び 関連機器 (直前四半期比▲11.7%)	チップ積層セラミックコンデンサ、HDD用衝撃検知用センサ、 電源モジュール、近距離無線通信モジュール減少
カーエレクトロニクス (直前四半期比+3.1%)	チップ積層セラミックコンデンサ、LTCC基板、 近距離無線通信モジュール増加

(注) 当社推計値に基づいております

利益変動要因

(2011年度第2四半期→2011年度第3四半期)



2. 2011年度 業績予想 (2011年4月～2012年3月)

製品別売上予想

	2011年度 通期予想 (前年度比)	2011年度 第4四半期予想 (前四半期比)
コンデンサ	▲6%	▲3%
圧電製品	▲10%	▲5%
その他コンポーネント	▲5%	▲8%
通信モジュール	▲1%	▲8%
電源他モジュール	▲7%	▲3%
計	▲5%	▲6%

用途別売上予想

	2011年度 通期予想 (前年度比)	2011年度 第4四半期予想 (前四半期比)
AV	▲24%	▲12%
通信	横這い	▲10%
コンピュータ及び 関連機器	▲7%	+5%
カーエレクトロニクス	+3%	▲3%
家電・その他	▲10%	横這い
計	▲5%	▲6%

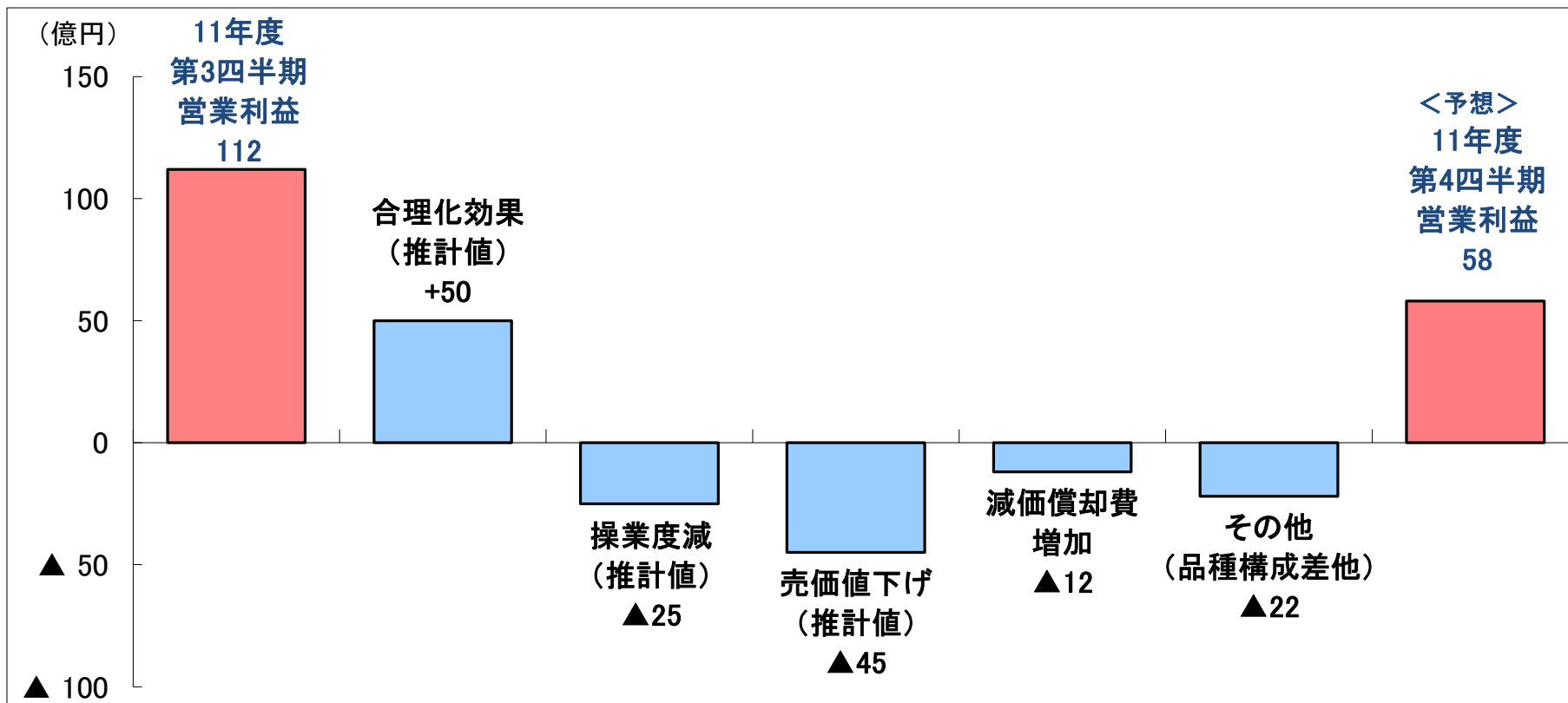
(注) 当社推計値に基づいております

2011年度の業績予想

	前回予想 (11年10月)		今回予想				
	2011年度 通期予想		2011年度 通期予想				
			上期 実績	第3四半期 実績	第4四半期 予想		
売上高	(億円)	(%)	(億円)	(億円)	(億円)	(億円)	(%)
	6,000	100.0	2,959	1,487	1,404	5,850	100.0
営業利益	560	9.3	310	112	58	480	8.2
税引前 当期純利益	620	10.3	347	122	71	540	9.2
当期純利益	420	7.0	237	78	46	360	6.2

利益変動要因

(2011年度第3四半期→2011年度第4四半期予想)



業績予想の前提

	2011年度			
	上期 実績	第3四半期 実績	第4四半期 予想	通期予想
減価償却費	285億円	156億円	168億円	610億円
研究開発費	200億円	102億円	98億円	400億円
設備投資額	337億円	156億円	208億円	700億円
為替レート(US\$)	79.81円/US\$	77.38円/US\$	77.00円/US\$	
為替レート(EUR)	113.78円/EUR	104.30円/EUR	100.00円/EUR	

当資料に記載されている、当社又は当社グループに関する見通し、計画、方針、戦略、予定、判断などのうち既に確定した事実でない記載は、将来の業績に関する見通しです。将来の業績の見通しは、現時点で入手可能な情報と合理的と判断する一定の前提に基づき当社グループが予測したものです。実際の業績は、さまざまなリスク要因や不確実な要素により業績見通しと大きく異なる可能性があり、これらの業績見通しに過度に依存しないようお願いいたします。また、新たな情報、将来の現象、その他の結果に関わらず、当社が業績見通しを常に見直すとは限りません。実際の業績に影響を与えるリスク要因や不確実な要素には、以下のものが含まれます。(1)当社の事業を取り巻く経済情勢、電子機器及び電子部品の市場動向、需給環境、価格変動、(2)原材料等の価格変動及び供給不足、(3)為替レートの変動、(4)変化の激しい電子部品市場の技術革新に対応できる新製品を安定的に提供し、顧客が満足できる製品やサービスを当社グループが設計、開発し続けていく能力、(5)当社グループが保有する金融資産の時価の変動、(6)各国における法規制、諸制度及び社会情勢などの当社グループの事業運営に係る環境の急激な変化、(7)偶発事象の発生、などです。ただし、業績に影響を与える要素はこれらに限定されるものではありません。

当資料に記載されている将来予想に関する記述についてこれらの内容を更新し公表する責任を負いません。